【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和7年4月11日(2025.4.11)

【公開番号】特開2024-124007(P2024-124007A)
【公開日】令和6年9月12日(2024.9.12)
【年通号数】公開公報(特許)2024-172
【出願番号】特願2023-31877(P2023-31877)
【国際特許分類】
Ｃ０９Ｊ　7/38(2018.01)
Ｃ０９Ｊ133/00(2006.01)
Ｂ３２Ｂ 27/00(2006.01)
Ｈ０１Ｌ 21/304(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０９Ｊ　7/38
Ｃ０９Ｊ133/00
Ｂ３２Ｂ 27/00　　Ｄ
Ｂ３２Ｂ 27/00　　Ｍ
Ｈ０１Ｌ 21/3046２２Ｊ

【手続補正書】
【提出日】令和7年4月1日(2025.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子装置の製造工程に用いる粘着性フィルムであって、
下記方法２により算出される１５０℃における応力残留率が５．０％以上９０．０％以下である粘着性フィルム。
[方法２]
前記粘着性フィルムを厚み１．４±０．１ｍｍになるまで積層したサンプルに対して、１３０℃、３０分の条件で熱処理を行うことで測定用サンプルを作製し、１０ｍｍ幅に切断した前記測定用サンプルに対して、動的粘弾性測定装置を用いて、温度：１５０℃、変形モード：圧縮、上治具：３点曲げ（圧子先端：２．５Ｒ）、下治具：パラレルプレート、測定時間：１０００秒、雰囲気：窒素の条件で、歪み２％を与え続けた際の応力を測定し、「（６００秒における応力［Ｐａ］／最も大きな応力が測定された時間の応力［Ｐａ］）×１００」の式により算出される値を、１５０℃における応力残留率［％］とする。
【請求項２】
基材層と、凹凸吸収性樹脂層と、熱硬化性粘着層とをこの順番に備える、請求項１に記載の粘着性フィルム。
【請求項３】
前記凹凸吸収性樹脂層と、前記熱硬化性粘着層とが、直に接するように設けられている、請求項２に記載の粘着性フィルム。
【請求項４】
前記熱硬化性粘着層は、（メタ）アクリル系樹脂と、熱重合開始剤とを含む、請求項２または３に記載の粘着性フィルム。
【請求項５】

前記凹凸吸収性樹脂層を構成する樹脂が、エチレン・酢酸ビニル共重合体、（メタ）アクリル系樹脂、エチレン・α－オレフィン共重合体、および低密度ポリエチレンからなる群から選択される少なくとも一種を含む、請求項２または３に記載の粘着性フィルム。
【請求項６】
前記凹凸吸収性樹脂層の厚みが２０μｍ以上５００μｍ以下である、請求項２または３に記載の粘着性フィルム。
【請求項７】
前記基材層を構成する樹脂が、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレンテレフタレート、およびポリイミドからなる群から選択される少なくとも一種を含む、請求項２または３に記載の粘着性フィルム。
【請求項８】
前記電子装置の製造工程は、回路形成面を有する電子部品と、前記電子部品の前記回路形成面側に貼り合わされた前記粘着性フィルムと、を備える構造体を準備する工程（Ａ）と、真空雰囲気下で、前記電子部品の前記回路形成面側とは反対側の面を処理する工程（Ｂ）と、を含む、請求項１～３のいずれかに記載の粘着性フィルム。
【請求項９】
前記電子装置がパワー半導体装置である、請求項１～３のいずれかに記載の粘着性フィルム。